

H 01 G

Ans.nr.: 4220/82

Indleveret: 22 sep 1982

Løbedag: 22 sep 1982

Alm. tilgængelig: 24 mar 1983

Prioritet: 23 sep 1981 US 304890

E.I. DU *PONT DE NEMOURS AND COMPANY; Wilmington, US.

Opfinder: William Thomas *Hicks; US, William Carl *Seidel; US.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co

Metalliseringsmateriale til anvendelse som kondensatorkatodeovertræk samt dets anvendelse i tantalkondensatorer

S A M M E N D R A G

4220-82

Et metalliseringsmateriale til anvendelse som kondensatorkatodeovertræk, især til tantalkondensatorer, indeholder

(a) 92-97 vægtprocent af en blanding af 70-95 vægtprocent findelte kobberpartikler og 30-5 vægtprocent findelte partikler af tinholdigt metal, dispergeret i en opløsning af
(b) 4-1,5 vægtprocent af et organisk syre-flusmiddel med et syretal på mindst 100, og som er termisk stabilt op til en temperatur på mindst 230°C, og (c) 4-1,5 vægtprocent af

en organisk amin svarende til formlen
$$\begin{array}{c} \text{R} \\ | \\ \text{R}-\text{N}-\text{R} \end{array}$$
, i hvilken R i hvert enkelt tilfælde er udvalgt fra gruppen bestående af H, C₁₋₈-alkyl, C₂₋₄-alkenyl og C₁₋₄-hydroxyalkyl, idet mindst én af grupperne R er alkyl eller hydroxyalkyl, i
(d) et indifferent organisk medium.

Et katodisk overtræk på en tantalkondensator kan påføres

ved, at man (1) neddypper en kondensatorkugle eller et lignende legeme i et flydende bad af det ovennævnte materiale til dannelse af et overtræk derpå, (2) tørrer materialet til fjernelse af flygtige bestanddele fra det organiske medium og (3) opvarmer det tørrede overtræk ved en temperatur på mindst 220°C , men under sønderdelingstemperaturen for Cu_3Sn , i et tidsrum tilstrækkeligt til at tilvejebringe reaktion mellem mindst 50 vægtprocent af tinnet med kobbermetallet i overtrækket til dannelse af den intermetalliske forbindelse Cu_3Sn .